

强于大市

半导体行业周报

多家企业 IPO 进程推进，三季度业绩普遍高增

半导体材料国产化进程提速，国内半导体设备厂商持续推新，有力推动新工艺覆盖和国产化替代。晶圆代工产能及设备需求将持续以较高速增长，封测市场也将保持高景气，半导体全产业链持续受益。继续推荐半导体设备、材料等板块。

行业动态：

- **IPO 进度：多家企业 IPO 进程推进。**截至 2021/10/31，共有 132 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等，盛美、安路、灿勤即将发行，唯捷创芯、英集芯、思特威、拓荆纷纷过会，芯导科技获同意注册，纳芯微即将上会。
- **三季度业绩普遍高增长。**2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 31 日，共有 82 家半导体公司发布 2021 年前三季度业绩公告，其中 34 家归母净利润同比增幅超 100%，沪硅产业、晶晨股份、乾照光电同比扭亏为盈。环比来看，共有 46 家公司三季度单季度归母净利润实现正增长。其中，普冉股份、华微电子、江化微、容大感光、派瑞股份、晓程科技归母净利润环比涨幅超过 100%。分子行业来看，披露业绩的 6 家半导体设备公司均实现归母净利润同比正增长，至纯科技、北方华创、长川科技同比涨幅超过 100%。21 家半导体材料公司中 12 家实现归母净利润同比正增长，晶瑞电材、阿石创、神工股份、中环股份、立昂微同比增幅超过 100%。
- **半导体材料：沪硅产业 12 寸重掺硅片已开展研发，目前产品以轻掺为主。**沪硅产业 (688126.SH) 10 月 29 日在投资者互动平台表示，公司 12 寸重掺硅片已开展研发，目前产品以轻掺为主。公司会持续加强产品研发工作。重掺系列具有电阻率低的特点且 12 寸硅片占比将不断提高，根据 SEMI 预测，至 2022 年，12 寸硅片占比将达 56.6%。
- **半导体设备：9 月北美及日本半导体设备出货额环比均有上涨。**据 SEMI 统计，9 月北美半导体设备出货金额为 37.2 亿美元，较 8 月的 36.5 亿美元上升 1.9%，较 2020 年同期 27.4 亿美元上升 35.5%。据日本半导体制造装置协会统计，9 月日本半导体设备出货金额大幅上涨，较 8 月的 2457 亿日元上涨 10.9%，相比于 2020 年同期 1884 亿日元上升 39%。
- **晶圆代工：晶圆代工产值将持续高增，Siltronic 12 英寸晶圆厂破土动工。**根据 TrendForce 集邦咨询表示，“芯片荒”叠加晶圆代工产能供不应求推升前十大晶圆代工业者产值在 2020 及 2021 年连续两年年化增速超过 20%，突破千亿美元大关。展望 2022 年，在台积电为首的涨价潮带动下，预计明年晶圆代工产值将达 1,176.9 亿美元，增长 13.3%。德国硅晶圆制造商世创电子 (Siltronic) 宣布，其位于新加坡 JTC 淡滨尼晶圆厂园区的 300mm (12 英寸) 制造工厂破土动工，预计到 2024 年底投资约 20 亿欧元 (约合人民币 148.06 亿元)。
- **封装测试：利扬芯片定增股票申请获上交所受理。**公司于 2021 年 10 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于受理广东利扬芯片测试股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，上交所依据对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
- **第三代半导体：Wolfspeed 再获大单。**Wolfspeed 宣布与致瞻科技 (上海) 有限公司的成功合作。致瞻科技燃料电池汽车全碳化硅控制器里采用了 Wolfspeed® 1200V SiC MOSFET。

投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；建议关注：晶盛机电、光力科技、神工股份
- **材料组合建议关注：**沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体组合：**新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注：**圣邦股份、思瑞浦、卓胜微 (射频)
- **MCU：**兆易创新；建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

- 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体材料国内市场增速放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

相关研究报告

《半导体行业周报：三季度业绩普遍高增长，TSMC、ASML、Lam Research 对 2022 年及以后的行业前景普遍乐观》20211025

《Lam Research 21Q3 业绩点评及电话会议纪要：技术差异化创新，新型刻蚀、薄膜沉积、镀铜技术开发助力客户制程进步并提升自身市场份额》20211024

《ASML 21Q3 业绩点评及电话会议纪要：在手订单 196 亿欧元交货持续到 2023 年，2022 年存储客户采购需求乐观》20211021

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

半导体

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余媛媛

(8621)20328550

yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

目录

拟 IPO 的半导体企业汇总	4
半导体设备国产化情况	8
2021 年前三季度业绩公告	9
行业数据回顾	18
上周信息汇总	22
IC 设计	22
半导体设备	23
半导体材料	23
封测	24
第三代半导体	24
风险提示	26

图表目录

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)	4
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)	5
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)	6
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)	7
图表 2. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化情况及主要国内厂家	8
图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	9
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	10
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	11
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	12
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	13
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	14
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	15
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	16
续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	17
图表 4. 全球半导体销售额当月值	18
图表 5. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比	18
图表 6. 日本半导体设备制造商出货额与同比	19
图表 7. 美国与国内半导体指数对比	19
图表 8. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比	19
图表 9. 美国与国内半导体指数对比(周度环比)	20
图表 10. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (周度环比)	20
图表 11. 申万半导体材料指数	20
图表 12. 全球半导体级硅片出货量预测	21
图表 13. 半导体器件封装材料进出口金额	21
图表 14. 半导体器件封装材料进出口单价	21
图表 15. 上周半导体相关个股周度涨跌幅	21

拟 IPO 的半导体企业汇总

截至 2021/10/31，共有 132 家半导体企业申报 IPO。上周是半导体 IPO 最丰收的一周：盛美、安路、灿勤即将发行，唯捷创芯、英集芯、思特威、拓荆纷纷过会，芯导科技获同意注册，纳芯微即将上会。

- **询价，即将上会：**盛美股份（清洗、FN、镀铜设备供应商）、安路科技（FPGA、SoC、EDA 设计公司）、灿勤科技（微波介质陶瓷元器件供应商）
- **证监会同意注册：**芯导科技（功率半导体设计公司）
- **过会：**唯捷创芯（射频前端及高端模拟芯片设计）、英集芯（数模混合芯片设计公司）、思特威（高性能 CMOS 图像传感器芯片）、拓荆科技（薄膜沉积设备供应商）
- **待上会：**东微半导体（高性能功率器件）、纳芯微（车规级传感器及信号链芯片）
- **问询：**安芯电子（FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片）
- **已受理：**晶华微（HART 调制解调器芯片、4~20mA 电流 DAC 芯片）

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/10/31）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	盛美股份	询价，即将发行	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
2	安路科技	询价，即将发行	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件（FPGA）、可编程系统级芯片（SoC）、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
3	灿勤科技	询价，即将发行	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
4	炬芯科技	已注册	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等
5	芯导科技	同意注册	国元证券	2009	设计	功率半导体
6	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
7	屹唐股份	提交注册	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
8	东芯股份	提交注册	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
9	【苏州】国芯科技	提交注册	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
10	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
11	创耀科技	提交注册	海通证券	2006	设计	通信芯片
12	云天励飞	提交注册	中信证券	2014	设计	AI 芯片
13	必易微	提交注册	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
14	概伦电子	提交注册	招商证券	2010	软件	EDA 软件
15	华大九天	过会	中信证券	2009	软件	EDA 软件
16	晶导微	过会	中信证券	2013	分立器件	二极管、整流桥等分立器件、集成电路系统级封装(SiP)
17	长光华芯	过会	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
18	华卓精科	过会	东兴证券	2012	零部件	超精密测控装备部件及整机，首家光刻机双工件台厂商
19	天岳先进	过会	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
20	炬光科技	过会	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
21	思特威	过会	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
22	英集芯科技	过会	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
23	拓荆科技	过会	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
24	唯捷创芯	过会	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
25	希荻微	待上会	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
26	东微半导体	待上会	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
27	纳芯微	待上会	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
28	芯龙半导体	问询	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
29	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
30	江波龙	问询	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
31	莱特光电	问询	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
32	龙芯中科	问询	中信证券	2010	设计	CPU
33	晶合集成	问询	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
34	麦斯克	问询	国泰君安	1995	材料	硅片
35	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
36	比亚迪半导体	问询	中金公司	2004	设计	功率半导体
37	赛微微	问询	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片
38	中微股份 (深圳)	问询	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
39	龙腾半导体	问询	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
40	盛景微	问询	光大证券	2016	设计	物联网控制芯片
41	臻镭科技	问询	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
42	天德钰	问询	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
43	奥比中光	问询	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
44	好达电子	问询	安信证券	1999	设计	SAW Filter
45	焊映微	问询	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
46	峰岷科技	问询	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
47	广立微	问询	中金公司	2003	软件/设备	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
48	富乐德	问询	光大证券	2017	服务	泛半导体 (半导体、显示面板等) 领域设备精密洗净、维修等服务
49	中科蓝讯	问询	中金公司	2016	设计	无线音频 SoC 芯片
50	国微思尔芯	问询	中金公司	2003	软件	EDA
51	路维光电	问询	国信证券	2012	材料	掩模板
52	联动科技	问询	海通证券	1998	设备	半导体自动化测试系统
53	安芯电子	问询	国元证券	2012	设计	FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片
54	思科瑞	暂缓审议	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
55	晶华微	已受理	海通证券	2005	设计	HART 调制解调器芯片、4~20mA 电流 DAC 芯片
56	恒烁股份	已受理	国元证券	2015	设计	存储芯片和 MCU 芯片研发
57	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
58	铖昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
59	杰理科技	已申报	中信建投	2014	设计	射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片 (SOC)
60	国博电子	已申报	招商证券	2010	设计	有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频
61	德邦科技	已申报	东方证券	2003	材料	半导体封装、粘合、散热等功能性材料
62	德明利	已申报	东莞证券	2008	设计	闪存主控芯片
63	华微科技	已申报	华泰联合	2003	设计	MCU、FPGA、电源管理芯片
64	艾森半导体	完成上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
65	江苏影速	完成上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
66	海光信息	完成上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
67	帝奥微电子	完成上市辅导	中信建投	2010	设计	混合信号产品线、电源管理、ACDC 高压大功率产品、模拟集成电路设计
68	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
69	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
70	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
71	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
72	歌尔微电子	上市辅导	中信建投	2017	设计	MEMS 芯片、ASIC 芯片、智能语音处理芯片
73	和美精艺	上市辅导	开源证券	2007	材料	封装基板
74	金誉半导体	上市辅导	浙商证券	2011	设计	电源管理芯片、低中高压 MOS 管、单片机和功率器件
75	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
76	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
77	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
78	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
79	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管
80	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
81	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
82	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
83	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
84	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
85	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
86	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
87	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	一站式定制芯片及 IP 供应商
88	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
89	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
90	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
91	兰宝传感	上市辅导	海通证券	1998	设计	传感器
92	敏芯半导体	上市辅导	中金公司	2017	设计	光通信用激光器和探测器芯片
93	泰凌微	上市辅导	安信证券	2010	设计	高性能低功耗无线物联网 SOC
94	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
95	飞骧科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
96	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料
97	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
98	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
99	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
100	芯愿景	上市辅导	民生证券	2002	设计	IC 技术分析、IC 设计服务
101	越亚半导体	上市辅导	方正证券	2006	材料	封装基板
102	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
103	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权
104	新恒汇电子	上市辅导	平安证券	2017	封测/材料	晶圆测试减划、封装材料高精度蚀刻金属引线框架、物联网 eSIM 封装
105	映日科技	上市辅导	安信证券	2015	材料	靶材
106	绍兴中芯	上市辅导	海通证券	2018	代工	专注于功率、传感和传输应用, 特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工服务的制造商
107	有研半导体	上市辅导	中信证券	2001	材料	硅片
108	京仪装备	上市辅导	国泰君安	2016	设备	半导体温控装置系列 (Chiller)
109	盛科通信	上市辅导	中金公司	2019	设计	以太网交换芯片
110	思必驰	上市辅导	中信证券	2007	设计	AI 芯片
111	欣盛半导体	上市辅导	中信建投	2016	IDM	COF 封装显示驱动芯片
112	振华风光	上市辅导	中信证券	2005	IDM	高可靠半导体模拟集成电路
113	立功科技	上市辅导	国信证券	1999	分销	代理分销
114	蓝箭电子	上市辅导	金元证券	1998	分立器件	三极管、二极管和场效应管, 同时对外承接半导体封装测试
115	兴福电子	上市辅导		2008	材料	电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品
116	燕东微	上市辅导	中信建投	1987	IDM	功率半导体、声光电传感器、声光电 ASIC、精密器件
117	微导纳米	上市辅导	浙江证券	2015	设备	ALD 和 RIE
118	新相微	上市辅导	中金公司	2005	设计	LCD 驱动芯片、CMOS SENSOR

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/31)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
119	慧智微	上市辅导	华泰联合	2011	设计	高性能微波射频前端芯片
120	灿瑞科技	上市辅导	中信证券	2005	设计	光电驱动芯片、磁传感器、光学传感器
121	海光芯创	上市辅导	华泰联合	2011	设计	光电子芯片和光电子器件
122	忆恒创源	上市辅导	中金公司	2011	设计	企业级 NVMe SSD 产品
123	新汇成	上市辅导	海通证券	2011	封测	驱动 IC 的金凸块、测试、切割和封装 (COG/COF) 服务
124	芯思杰	上市辅导	中信证券	2015	制造	光芯片设计、制造、封测
125	汇春科技	上市辅导	长江证券	2007	设计	光电成像、触控、MCU 等芯片
126	钜泉光电	上市辅导	国金证券	2005	设计	计量芯片、MCU 和电力载波芯片
127	星宸科技	上市辅导		2017	设计	视频监控芯片
128	中感微	上市辅导	国金证券	2009	设计	音频传感网主芯片、视频传感网芯片、电池电源管理芯片
129	腾盛精密	上市辅导	国金证券	2006	设备	封测设备
130	佰维储存	上市辅导	中信证券	2010	封测	智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组和以 SiP 为核心的先进封测服务
131	润玛电子	上市辅导	海通证券	2002	材料	微电子制造用超净高纯电子化学品
132	招金励福	上市辅导	民生证券	2002	材料	封装材料

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

半导体设备国产化情况

据国内主流 12 英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在 12 类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为 82.4%，CMP、清洗、热处理、刻蚀、PVD 等设备的国产化率接近或超过 20%。镀铜、CVD、量测、离子注入、光刻、涂胶显影等设备的国产化程度仍处于较低水平。

图表 2. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化情况及主要国内厂家

序号	设备名称	国产化率(%)	主要国内厂家
1	去胶设备	82.4	屹唐半导体
2	CMP 设备	26.5	华海清科
3	清洗设备	25.0	盛美半导体、北方华创、芯源微
4	热处理设备	24.7	北方华创、屹唐半导体、盛美半导体
5	刻蚀设备	22.4	中微公司、北方华创、屹唐半导体
6	PVD 设备	19.8	北方华创
7	镀铜设备	4.0	盛美半导体
8	CVD 设备	3.1	沈阳拓荆、盛美半导体
9	量测设备	2.8	上海精测、中科飞测、上海睿励、东方晶源
10	离子注入设备	1.5	中科信、万业企业
11	光刻设备	1.4	上海微电子
12	涂胶显影设备	1.1	芯源微

资料来源：中国国际招标网，中银证券

2021 年前三季度业绩公告

2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 31 日，共有 82 家半导体公司发布 2021 年前三季度业绩公告，其中 34 家归母净利润同比增幅超 100%，沪硅产业、晶晨股份、乾照光电同比扭亏为盈。环比来看，共有 46 家公司三季度单季度归母净利润实现正增长。其中，普冉股份、华微电子、江化微、容大感光、派瑞股份、晓程科技归母净利润环比涨幅超过 100%。分子行业来看，披露业绩的 6 家半导体设备公司均实现归母净利润同比正增长，至纯科技、北方华创、长川科技同比涨幅超过 100%。披露业绩的 21 家半导体材料公司中 12 家实现归母净利润同比正增长，晶瑞电材、阿石创、神工股份、中环股份、立昂微同比涨幅超过 100%。

图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
1	数字芯片设计	300053.SZ	欧比特	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4369.26 万元,比上年同期减少 11.57 %	主要系营业收入减少所致。	2021/10/29
2	数字芯片设计	300102.SZ	乾照光电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.65 亿,比上年同期增加 168.44 %	主要系受 LED 行业市场回暖,以及南昌蓝绿芯片项目产能释放,致使公司营业收入增加影响所致。	2021/10/27
3	数字芯片设计	300223.SZ	北京君正	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.35 亿,比上年同期增长 2,733.52 %	年初至报告期期末,公司各产品线市场需求旺盛,致公司营业收入保持增长。同时,北京矽成自 2020 年 5 月 31 日开始纳入合并范围,致同比变动较大。	2021/10/27
4	数字芯片设计	300458.SZ	全志科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3.89 亿,比上年同期增加 121.16 %	主要系本期智能硬件、智能车载、编解码等产品线营业收入比上年同期增加所致。	2021/10/26
5	数字芯片设计	300613.SZ	富瀚微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.69 亿,比上年同期增长 554.37 %	主要以产品销售同比增长所致。	2021/10/25
6	数字芯片设计	600703.SH	三安光电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 12.86 亿,比上年同期增加 37.04 %	主要系报告期内产品销量、营业收入大幅增长,增加利润所致。	2021/10/29
7	数字芯片设计	603501.SH	韦尔股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 35.18 亿,比上年同期增长 103.78 %	主要系销售规模增加及非经常性损益增加所致。	2021/10/30
8	数字芯片设计	603893.SH	瑞芯微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4.08 亿,比上年同期增长 116.16 %	主要系营业收入增加,非经常性损益增加所致。	2021/10/28

资料来源: 万得, 中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
9	数字芯片设计	688008.SH	澜起科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 5.12 亿,比上年同期减少 41.62 %	(1) 本年度前三季度毛利较高的互连类芯片产品线营业收入较上年同期减少 23.23%; (2) DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期, 导致本年度前三季度产品价格较上年同期有所下降, 互连类芯片产品线毛利率由上年同期的 73.58% 下降为本期的 65.38%; (3) 本年度前三季度研发投入较上年同期增加 10.86%。	2021/10/29
10	数字芯片设计	688018.SH	乐鑫科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.48 亿,比上年同期增加 83.32 %	主要系三项因素综合影响所致: 一是营业收入的增长, 二是毛利率的控制, 三是研发费用的增长。	2021/10/26
11	数字芯片设计	688099.SH	晶晨股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 5.02 亿,比上年同期增长 3,874.75 %	营业收入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力提升。	2021/10/28
12	数字芯片设计	688123.SH	聚辰股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8259.68 万元,比上年同期减少 30.87 %	主要系公司间接持有中芯国际股份, 受中芯国际股价波动影响, 上年同期取得的投资收益较高所致。扣除相关投资收益影响后, 公司年初至报告期末归属于母公司股东的净利润为 7,470.33 万元, 较上年同期增长 2.67%。	2021/10/26
13	数字芯片设计	688385.SH	复旦微电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3.88 亿,比上年同期增长 266.09 %	主要系下游市场需求旺盛, 营业收入增加及产品毛利率提升。	2021/10/29
14	数字芯片设计	688521.SH	芯原股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 -2181.63 万元	由于公司营业收入增加, 盈利能力逐步提升, 同时由于规模化优势体现, 研发投入占收入比重下降, 年初至报告期末净亏损收窄。	2021/10/30
15	数字芯片设计	688589.SH	力合微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1735.17 万元,比上年同期增长 116.61 %	主要系营业收入增加及闲置资金保本理财所获投资收益增加所致。	2021/10/28
16	数字芯片设计	688766.SH	普冉股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.23 亿,比上年同期增加 373.66 %	主要系公司通过研发实现工艺制程的升级、新产品的量产以及原有产品的迭代, 提升了公司的产品的竞争力, 同时, 全球半导体行业持续景气, 平均单价上涨高于成本涨幅, 使得公司净利润增长。	2021/10/30
17	数字芯片设计	002049.SZ	紫光国微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 13.59 亿,比上年同期增长 112.90 %	主要系公司集成电路业务规模增长所致。	2021/10/26

资料来源: 万得, 中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
18	数字芯片设计	688256.SH	寒武纪	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 -6.29 亿	年初至报告期末比上年同期亏损增加 31,994.63 万元, 主要系年初至报告期末研发人员投入、研发资产折旧摊销及确认的股份支付较上年同期增加所致。	2021/10/30
19	数字芯片设计	688728.SH	格科微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 9.33 亿, 比上年同期增长 42.53%	主要系公司当期营业收入增加、毛利提升所致。	2021/10/29
20	数字芯片设计	002180.SZ	纳思达	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.75 亿, 比上年同期增长 62.53%	主要系营业收入增加所致。	2021/10/29
21	数字芯片设计	300493.SZ	润欣科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4495.59 万元, 比上年同期增长 43.37%	主要系上年同期受疫情影响, 销售收入减少, 本报告期销售规模扩大, 收入增加。	2021/10/29
22	数字芯片设计	603986.SH	兆易创新	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 16.48 亿, 比上年同期增长 144.92%	增加项: 1. 芯片产品市场需求增加, 产品销量增长; 公司合理利用新增产能供应, 优化产品结构; 随市场供需紧张, 公司产品售价有所提高。公司毛利率提高, 毛利润同比增加约 15.14 亿元; 2. 财务费用减少约 1.23 亿元, 其中利息收入增加约 0.93 亿元、汇兑损失减少约 0.30 亿元; 减少项: 1. 销售费用、管理费用和研发费用增加约 4.75 亿元, 其中研发费用增加约 2.49 亿元。费用的增加是由于公司加大投入, 薪酬增加以及实施员工股权激励计划, 人工费用增加以及研发材料、摊销折旧以及与销售相关的物流等费用增加; 2. 盈利增加, 计提的所得税费用同比增加约 1.71 亿元。	2021/10/28
23	数字芯片设计	688608.SH	恒玄科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.94 亿, 比上年同期增长 151.31%	主要系公司营收快速增长, 带来公司营业利润增长。同时, IPO 募集资金的投资收益带给公司较大非经常性收益。本报告期内受上游供应链涨价影响, 公司毛利率有所下降, 为 36.04%, 比去年同期 40.81%, 下降 4.77 个百分点, 同时本报告期研发费用较去年同期增长 101.27%, 使得公司本报告期扣除非经常性损益的净利增长明显慢于本报告期营业收入增长幅度。	2021/10/27

资料来源: 万得, 中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
24	模拟芯片设计	300139.SZ	晓程科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8627.75 万元,比上年同期增长 1,902.41%	本期加纳黄金销售收入增加所致。	2021/10/27
25	模拟芯片设计	603068.SH	博通集成	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4946.99 万元,比上年同期减少 14.65 %	主要系营业收入减少所致。	2021/10/30
26	模拟芯片设计	688286.SH	敏芯股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 843.51 万元,比上年同期减少 72.82 %	主要系本年度较上年度股份支付增加影响所致。	2021/10/29
27	模拟芯片设计	688536.SH	思瑞浦	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3.12 亿,比上年同期增长 91.46 %	主要系营业收入大幅增长,使得净利润相应增加所致。	2021/10/29
28	模拟芯片设计	688601.SH	力芯微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.15 亿,比上年同期增长 109.11%	主要系本期公司积极拓展业务,产品结构进一步优化,毛利率上升,营业收入持续增长所致。	2021/10/27
29	模拟芯片设计	688798.SH	艾为电子	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.96 亿,比上年同期增加 144.87 %	主要为本期业务规模增加,且收入的增加幅度大于成本费用的增加幅度,形成本期净利润的增长。	2021/10/30
30	模拟芯片设计	300395.SZ	菲利华	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.90 亿,比上年同期增加 77.29 %	报告期销售订单增加,销售规模扩大。	2021/10/29
31	模拟芯片设计	688699.SH	明微电子	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.00 亿,比上年同期增加 926.25%	主要系下游应用领域需求旺盛,产品量价齐升,营业收入和净利润均大幅增长。	2021/10/25
32	模拟芯片设计	300661.SZ	圣邦股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4.51 亿,比上年同期增长 117.93%	主要原因系报告期公司业务增长、产品销量增加,相应营业收入增加所致。	2021/10/27
33	模拟芯片设计	603160.SH	汇顶科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.15 亿,比上年同期减少 44.06%	主要系营收及毛利下降影响所致。	2021/10/28
34	模拟芯片设计	688002.SH	睿创微纳	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4.24 亿,比上年同期减少 8.84%	主要系公司扩大管理、销售、研发团队,导致各项期间费用中人工成本增长所致。	2021/10/28
35	模拟芯片设计	688508.SH	芯朋微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.29 亿,比上年同期增长 117.72 %	主要系公司不断优化产品结构毛利率提升,利润同步增长。	2021/10/28

资料来源:万得,中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
36	模拟芯片设计	688595.SH	芯海科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8292.43 万元,比上年同期增长 36.63%	2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东净利润 8,292.43 万元,较去年同期增长 36.63%,剔除与日常经营无关因素(股份支付及通富微股票投资损失)后,较去年同期增长 125.62%,增长原因主要系营收增长及管理效率提升。	2021/10/29
37	模拟芯片设计	300671.SZ	富满微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4.85 亿,比上年同期增长 687.85 %	主要系报告期公司产品销售增加影响。	2021/10/27
38	集成电路制造	688396.SH	华润微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 16.84 亿,比上年同期增长 145.20 %	主要系因公司营业收入同比增长 41.70%,公司整体毛利率同比提升 7.51 个百分点。	2021/10/27
39	集成电路制造	300456.SZ	赛微电子	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8754.87 万元,比上年同期增加 18.49 %	主要系营业收入增加所致。	2021/10/27
40	集成电路封测	002156.SZ	通富微电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 7.03 亿,比上年同期增长 168.56 %	受全球智能化加速发展、电子产品需求增长等因素影响,公司国际和国内客户的订单需求保持旺盛态势,公司在高性能计算、5G、存储器、消费类电子、功率器件、工业及汽车电子、显示驱动等方面的业务持续扩大,公司订单饱满,营收规模和经营业绩继续保持增长趋势。	2021/10/30
41	集成电路封测	002185.SZ	华天科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 10.28 亿,比上年同期增长 129.78 %	主要为本报告期订单饱满,生产经营规模扩大所致。	2021/10/29
42	集成电路封测	600584.SH	长电科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 21.16 亿,比上年同期增长 176.84%	主要系:1、国内外客户需求强劲,订单饱满。同时,各工厂持续调整产品结构,降本增效,毛利率得到有效提升;2、公司严格控制各项营运费用,不断优化财务结构,降低财务费用;3、处置参股公司 SJ SEMICONDUCTOR Corporation 股权收益。	2021/10/28
43	集成电路封测	688216.SH	气派科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.09 亿,比上年同期增长 96.66 %	主要系公司前三季度收入较上年同期增加,规模效应和产品价格提升使毛利率较上年同期有所提升所致。	2021/10/28

资料来源:万得,中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
44	集成电路封测	688135.SH	利扬芯片	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 7749.45 万元, 比上年同期增加 153.36%	主要系公司营业收入大幅增长, 2021 年第三季度测试订单饱满, 产能处于满负荷运转状态, 规模效应使得固定成本分摊降低, 带来营业利润大幅增长。	2021/10/30
45	集成电路封测	002077.SZ	大港股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.67 亿, 比上年同期增加 56.46%	主要是报告期参股公司股票减持收益及公允价值变动收益增加; 联营公司投资收益增加; 融资规模下降, 减少了财务费用。	2021/10/29
46	集成电路封测	600667.SH	太极实业	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 6.04 亿, 比上年同期增长 16.08%	本期营业收入增加所致	2021/10/28
47	集成电路封测	603005.SH	晶方科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 4.14 亿, 比上年同期增长 54.26%	主要系封装出货量增加所致。	2021/10/30
48	分立器件	002079.SZ	苏州固锴	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.85 亿, 比上年同期增长 148.23%	主要是本期营业收入同比快速增长所致。	2021/10/29
49	分立器件	300046.SZ	台基股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 5582.02 万元, 比上年同期增长 79.14%	主要是营业收入增加所致。	2021/10/27
50	分立器件	300831.SZ	派瑞股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 4146.97 万元, 比上年同期增长 47.09%	主要是营业收入增加所致。	2021/10/27
51	分立器件	600360.SH	华微电子	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 6161.32 万元, 比上年同期增长 222.53%	主要原因系报告期内, 公司营业收入上升、市场结构调整, 净利润增加。	2021/10/29
52	分立器件	600460.SH	士兰微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 7.28 亿, 比上年同期增长 1,543.39%	2021 年 1-9 月公司整体制造规模效益逐步显现, 士兰集昕 8 吋芯片生产线逐步扭亏为盈; 士兰明芯 LED 芯片生产线亏损大幅减少; 公司集成电路和分立器件产品销量较去年同期大幅增长, 产品结构调整推动毛利率持续提升。	2021/10/30
53	分立器件	688689.SH	银河微电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.05 亿, 比上年同期增长 112.27%	主要系营业收入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力提升。	2021/10/29
54	分立器件	603290.SH	斯达半导	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 2.67 亿, 比上年同期增长 98.71%	主要系公司收入增长, 盈利能力提升所致。	2021/10/30

资料来源: 万得, 中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
55	半导体设备	002371.SZ	北方华创	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.58 亿,比上年同期增加 101.57 %	销售订单、生产规模较上期增加,相应的收入增加。	2021/10/29
56	半导体设备	003043.SZ	华亚智能	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8277.24 万元,比上年同期增长 40.43 %	主要系公司当期营业收入增加所致。	2021/10/30
57	半导体设备	300604.SZ	长川科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.30 亿,比上年同期增加 265.41 %	主要系本期销售增加从而导致母公司盈利增加	2021/10/25
58	半导体设备	603690.SH	至纯科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.88 亿,比上年同期增长 127.96 %	主要系公司收入规模整体增加、公允价值变动损益及补贴收入增加所致。	2021/10/30
59	半导体设备	688012.SH	中微公司	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 5.42 亿,比上年同期增加 95.66 %	主要系: (1) 扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加约 2.10 亿元; (2) 计入当期损益的政府补助(非经常性损益)增加了 0.96 亿元	2021/10/28
60	半导体设备	688037.SH	芯源微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 5308.62 万元,比上年同期增长 18.80 %	主要系同期毛利率降低,研发费用等费用增加所致。由于本期前道产品收入占比提高,且前道产品仍处于市场开拓期毛利率较低,从而拉低了整体毛利率。	2021/10/30
61	半导体材料	002129.SZ	中环股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 27.61 亿,比上年同期增加 226.29 %	主要系随着公司产能提升,销售规模增加。	2021/10/26
62	半导体材料	002409.SZ	雅克科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3.90 亿,比上年同期增长 13.26 %	主要系公司当期营业收入增加所致。	2021/10/28
63	半导体材料	003026.SZ	中晶科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.14 亿,比上年同期增加 83.62 %	主要系营业收入增加所致。	2021/10/29
64	半导体材料	300054.SZ	鼎龙股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.51 亿,比上年同期减少 37.27 %	主要系营业收入减少所致。	2021/10/28
65	半导体材料	300236.SZ	上海新阳	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8492.42 万元,比上年同期减少 51.99 %	主要系营业收入减少所致。	2021/10/29

资料来源: 万得, 中银证券

续图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
66	半导体材料	300346.SZ	南大光电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.24 亿, 比上年同期增长 38.58 %	主要是本期公司产品市场需求增长所致。	2021/10/28
67	半导体材料	300398.SZ	飞凯材料	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.70 亿, 比上年同期增加 59.34 %	主要系下游客户需求增加所致。	2021/10/29
68	半导体材料	300576.SZ	容大感光	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4250.91 万元, 比上年同期增长 3.21 %	主要系公司业务增长所致。	2021/10/29
69	半导体材料	300655.SZ	晶瑞电材	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.65 亿, 比上年同期增加 167.80 %	主要系本期公司产品市场需求旺盛, 销售量价齐升所致。	2021/10/25
70	半导体材料	300666.SZ	江丰电子	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 9525.47 万元, 比上年同期减少 13.37 %	主要为营业收入减少所致。	2021/10/28
71	半导体材料	300706.SZ	阿石创	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1224.00 万元, 比上年同期增长 251.47 %	主要系公司销量增加及非同一控制下企业合并增加所致。	2021/10/29
72	半导体材料	600206.SH	有研新材	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.12 亿, 比上年同期增加 41.86 %	主要系营业收入增加所致。	2021/10/28
73	半导体材料	603078.SH	江化微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2781.20 万元, 比上年同期减少 34.80 %	主要系营业收入减少所致。	2021/10/29
74	半导体材料	603306.SH	华懋科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.35 亿, 比上年同期减少 1.92 %	主要是公司销售产品结构调整, 营业收入中低毛利产品占比下降所致。	2021/10/27
75	半导体材料	603650.SH	彤程新材	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.76 亿, 比上年同期减少 16.20 %	主要系原料价格、运费上涨、研发投入加大及交易性金融资产公允价值变动所致。	2021/10/30
76	半导体材料	605358.SH	立昂微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 4.04 亿, 比上年同期增长 312.14 %	前三季度相比去年同期增加 27337.67 万元, 主要是营业收入大幅增加, 成本费用管控力度加强, 毛利率提升所致。	2021/10/25
77	半导体材料	688019.SH	安集科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 9703.98 万元, 比上年同期减少 14.58 %	主要系公司对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)公允价值变动所致。	2021/10/29

资料来源: 万得, 中银证券

续图表 3.上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

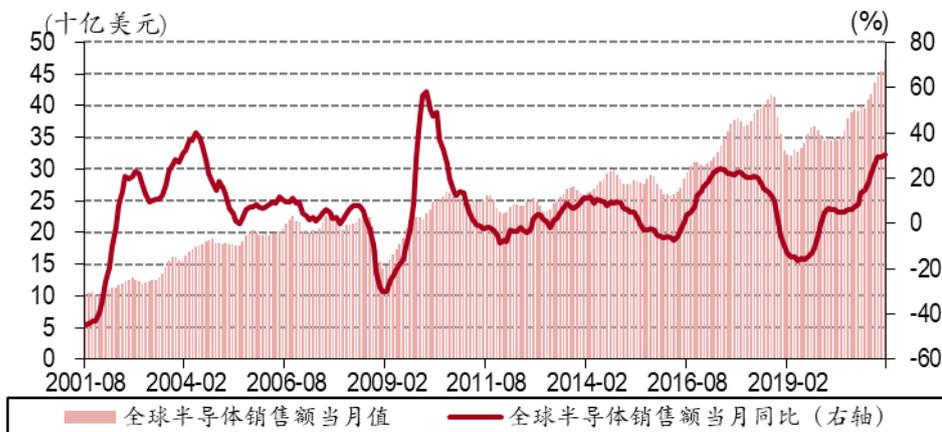
序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
78	半导体材料	688126.SH	沪硅产业	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.01 亿元	年初至本报告期末的归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加主要是由于公司销售增加带来的营业利润增加所致。	2021/10/29
79	半导体材料	688138.SH	清溢光电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 3096.70 万元,比上年同期减少 50.49%	主要系报告期内合肥子公司处于产能爬坡阶段,出现亏损。	2021/10/26
80	半导体材料	688233.SH	神工股份	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.69 亿,比上年同期增长 192.30 %	主要系公司主营产品销售收入增加所致。	2021/10/26
81	半导体材料	688268.SH	华特气体	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.03 亿,比上年同期增加 39.09 %	主要系与销售收入同步增长。	2021/10/28
82	IDM	600745.SH	闻泰科技	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 20.41 亿,比上年同期减少 9.64 %	主要系营业收入减少所致。	2021/10/30

资料来源: 万得, 中银证券

行业数据回顾

8月全球半导体销售额达472亿美元，同比增长30.2%，环比增长3.8%。据美国半导体产业协会SIA数据，8月全球半导体销售额继续保持增长，较7月销售额454亿美元增长3.8%。其中，8月份中国大陆半导体销售额为164.6亿美元，同比增长30.8%，环比增长3.4%。

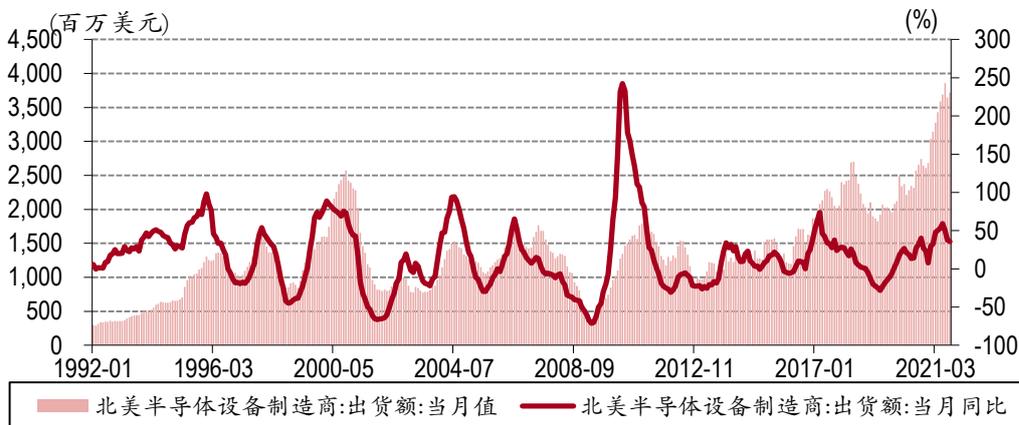
图表4. 全球半导体销售额当月值



资料来源：万得，美国半导体产业协会，中银证券

9月北美半导体设备出货金额37.2亿美元，较上月小幅回升。据SEMI统计，9月北美半导体设备出货金额为37.2亿美元，较8月的36.5亿美元上升1.9%，较2020年同期27.4亿美元上升35.5%。2021年1-9月份出货额的环比增幅分别为13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%、4.5%、-5.4%、1.9%。

图表5. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比



资料来源：万得，SEMI，中银证券

9月日本半导体设备出货金额2724亿日元，较上月大幅上涨。据日本半导体制造装置协会统计，9月日本半导体设备出货金额大幅上涨，较8月的2457亿日元上涨10.9%，相比于2020年同期1884亿日元上升39%。2021年1-9月份出货额的环比增幅分别为1.9%、3.7%、28.4%、17.2%、8.3%、-18.3%、-3.5%、2.1%、10.9%。

图表 6. 日本半导体设备制造商出货额与同比



资料来源：万得，日本半导体制造装置协会，中银证券

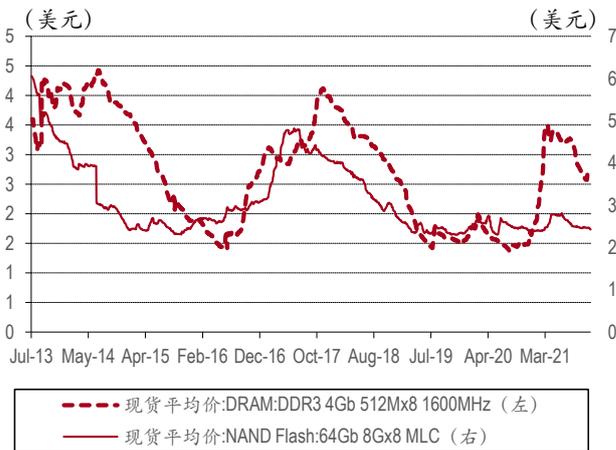
半导体指数小幅回升，存储价格继续回落。近一周申万行业半导体指数报 6,149.86 点，环比上涨 0.58%，延续前期震荡趋势，表明市场观点持续分化。费城半导体指数小幅上升，收报 3451.3 点，环比上涨 2.40%。近一周存储现货均价继续小幅下跌，NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 价格环比下跌 1.1%，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 价格较上周下跌 0.9%，存储价格继续回落。

图表 7. 美国与国内半导体指数对比



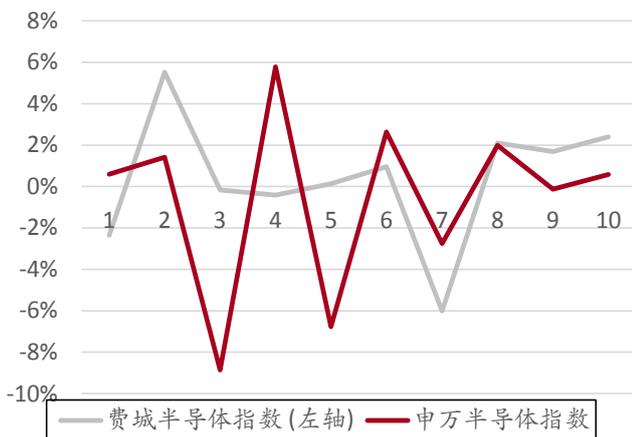
资料来源：万得，中银证券

图表 8. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比



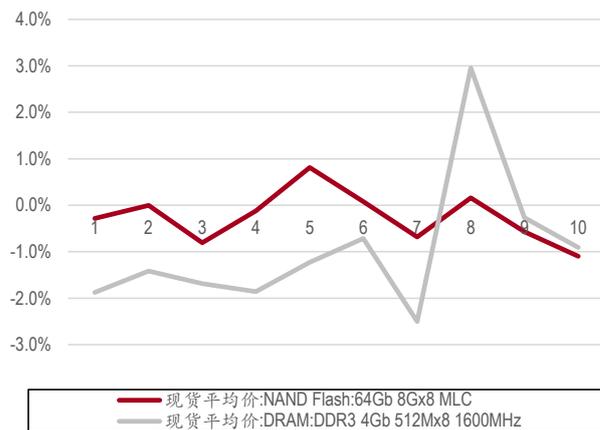
资料来源：万得，中银证券

图表 9. 美国与国内半导体指数对比(周度环比)



资料来源: 万得, 中银证券

图表 10. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比(周度环比)



资料来源: 万得, 中银证券

上周申万半导体材料指数收报 9894.08 点, 较上周下降 1.3%。10 月 12 日半导体材料指数收报 9110.1 点, 降至三个月低点, 之后半导体材料指数触底反弹, 截至 10 月 29 日半导体材料指数较 12 日低点已上涨 8.6%。

图表 11. 申万半导体材料指数



资料来源: 万得, SEMI, 中银证券

硅晶圆: SEMI 发布年度半导体产业硅晶圆出货预测报告, 沪硅产业 12 寸重掺硅片已开展研发, 目前产品以轻掺为主。SEMI 10 月 20 日发布年度半导体产业硅晶圆出货预测报告, 预估今年硅晶圆出货量增幅将达 13.9%, 接近 140 亿平方英寸。同时预估明年出货量将增长 6.4%, 达 148.96 亿平方英寸, 2023、2024 出货量将分别增长 4.6%、2.9%, 续创历史新高。沪硅产业 (688126.SH) 10 月 29 日在投资者互动平台表示, 公司 12 寸重掺硅片已开展研发, 目前产品以轻掺为主。公司会持续加强产品研发工作。

图表 12. 全球半导体级硅片出货量预测

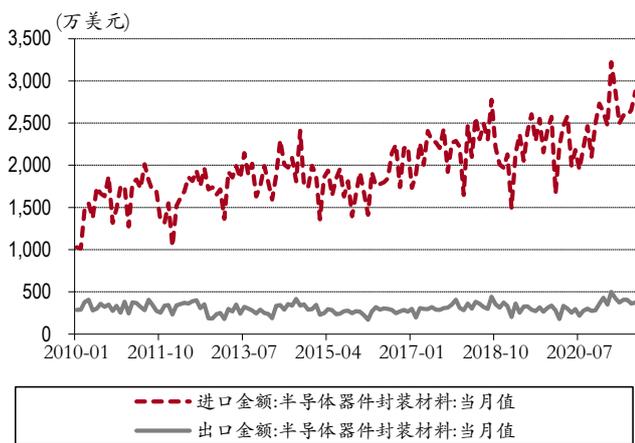


资料来源: SEMI, 中银证券

光刻胶: 上海新阳公告将支付 4500 万元受让芯刻微剩余的 30% 股权。芯刻微目前系公司的控股子公司, 仅进行 ArF 浸没式光刻胶的研发工作, 2020 年公司为了芯刻微引入战略投资者超成科技, 在超成科技作为芯刻微大股东的期间, 芯刻微完成了项目的前期研发、团队建设、实验室的工程建设工作, 并避免公司或有的风险损失, 保证了湿法光刻胶项目的正常开展。考虑到湿法光刻胶的研发工作已经达到了中试试验的基本条件, 为避免同业竞争并加快项目的测试验证工作, 上海新阳拟继续受让由超成科技持有的芯刻微剩余的 30% 股权, 将芯刻微纳入 100% 控股子公司。ArF 浸没式光刻胶在芯刻微实现了从无到有的过程并研发工作进展顺利, 取得可观的发展成果。

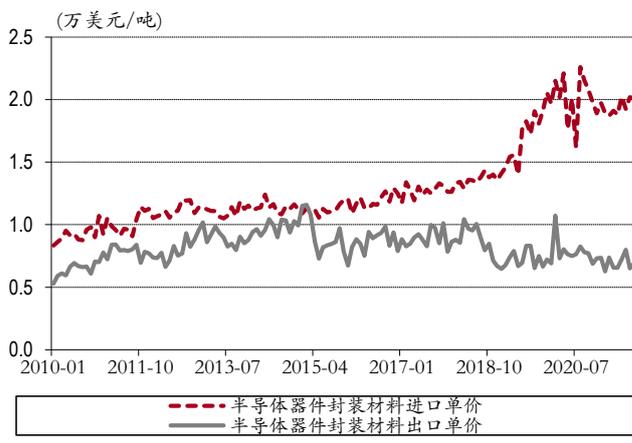
封装材料: 海关总署公布 9 月半导体封装材料进出口数据。9 月封装材料进口与出口金额同时走高, 收报 2,876 和 373 万美元, 环比 8 月上涨 8.2% 和 3.0%。从单价来看, 封装材料进口单价小幅下调, 收报 2.01 万美元/吨, 环比下降 0.5%, 出口单价走高收报 0.69 万美元/吨, 环比上涨 6.2%。

图表 13. 半导体器件封装材料进出口金额



资料来源: 万得, 海关总署, 中银证券

图表 14. 半导体器件封装材料进出口单价



资料来源: 万得, 海关总署, 中银证券

图表 15. 上周半导体相关个股周度涨跌幅

代码	简称	周度跌幅 (%)	代码	简称	周度涨幅 (%)
688286.SH	敏芯股份	(20.12)	688536.SH	思瑞浦	26.47
688018.SH	乐鑫科技	(15.90)	300139.SZ	晓程科技	24.63
600171.SH	上海贝岭	(15.66)	300672.SZ	国科微	24.52
688699.SH	明微电子	(12.68)	603688.SH	石英股份	16.12
688368.SH	晶丰明源	(12.32)	688008.SH	澜起科技	15.32

资料来源: 万得, 中银证券

上周信息汇总

IC 设计

【行业】芯朋集成电路设计产业园揭牌 半导体芯片研发等项目落户无锡旺庄

无锡高新区在线消息显示，芯朋集成电路设计产业园将从产业链入手，总部大楼一部分用作科创板上市公司无锡芯朋微电子股份有限公司总部办公及研发用房，其余用于引入与公司产业方向相关的科研机构、创业企业以及配套服务企业，通过产业园建设，引进、投资、孵化一批相关产业创新企业，做好集成电路设计产业“延链、补链、强链”，为旺庄经济高质量发展赋能加码。

(资料来源：无锡高新区在线)

【行业】扩大集成电路经营企业保险广度与深度，中国集成电路共保体在临港成立

10月27日，据上海临港消息，中国集成电路共保体（以下简称“集共体”）在上海临港新片区正式成立。上海临港消息显示，集共体是满足条件的中国境内的财产保险公司，在风险共担、合作共赢的原则下组建的合作组织，不具有独立法人资格。集共体围绕国家建立集成电路产业创新生态系统、维护集成电路产业链和供应链稳定、解决核心技术“卡脖子”等关键环节，通过产品创新、机制创新、服务创新，提供高质量、差异化、全流程的集成电路产业风险解决方案，助力构建中国集成电路自主、安全、可控的产业链和供应链，持续扩大集成电路经营企业、生产环节、技术领域的保险广度与深度。

(资料来源：上海临港)

【联发科】4 纳米芯片明年 Q1 放量 估明年 5G 芯片价量续扬

IC 设计大厂联发科（26）日召开法说会，执行长蔡力行表示，首颗采用台积电 4 纳米制程芯片将在明年首季正式放量，且受惠进入旗舰手机市场，预期明年 5G 芯片出货量及平均单价皆可持续提升。蔡力行指出，旗舰机种对联发科来说是全新的市场，但凭借独特设计架构、优异的低功耗设计，以及台积电 4 纳米制程，首款旗舰产品效能领先业界，有助联发科提升市占率。联发科该款 5G 旗舰芯片已获所有主要的中国大陆品牌采用，预计年底就会开始贡献营收，明年第一季则可进入放量阶段，未来也将推出更多旗舰级产品，进一步拓展市场。此外，5G 通讯商迈入第三年，今年全球 5G 渗透率约为 35-40%，蔡力行看好，明年 5G 渗透率将超过 50%，联发科目前已在全球手机市占取得领先，可持续受惠，也会抢进毫米波产品升级潮。

(资料来源：钜亨网)

【高通公司】高通发布骁龙 695 等四款芯片，预计将于 2021 年第四季度商用

高通公司 27 日凌晨宣布推出四款定位中级和入门级的处理器——骁龙 778G Plus 5G、骁龙 695 5G、骁龙 480 Plus 5G 和骁龙 680 4G，预计这批新品将会在今年第四季度上市。在市场强大需求刺激下，今年 10 月末高通铆足劲头一口气推出了四款新品，产品快速迭代的背后是性能的升级和功能的延伸。从当前市场来看，高通骁龙芯片的确够强。顶级旗舰系列采用骁龙 8 系列旗舰芯片，而中端机型则由骁龙 7 系列 SoC 护航。搭载了骁龙 888 移动平台的黑鲨游戏手机 4 Pro，在连续几个月都是安卓性能排行榜魁首。在 9 月份的安卓手机性能排行榜上，前十名也均是骁龙 8 系列手机。

(资料来源：全球半导体观察)

半导体设备

【晶盛机电】拟 57 亿定增加码碳化硅、半导体设备

10 月 25 日晚间，晶盛机电发布定增预案，拟向不超过 35 名（含）特定对象发行募集资金总额不超过 57 亿元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：31.34 亿元用于碳化硅衬底晶片生产基地项目，5.64 亿元用于 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目，4.32 亿元用于年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目，15.7 亿元用于补充流动资金。据悉，本次晶盛机电向特定对象发行股票的发行数量不超过 2.57 亿股（含本数）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。受惠于光伏和半导体热潮的影响，今年以来，晶盛机电股价持续走高，在 9 月初总市值一度触及千亿大关。截止到 10 月 25 日收盘，该股报价 74.96 元，上涨 1.99%，总市值为 963.66 亿。

（资料来源：晶盛机电官网）

【长川科技】前三季度归母净利 1.30 亿元，同比增长 265.41%

10 月 25 日，长川科技发布 2021 年第三季度报告。报告显示，前三季度，长川科技实现营业收入 10.69 亿元，同比增长 113.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，同比增长 265.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 1.12 亿元，同比增长 2977.73%。第三季度，长川科技实现营业收入 3.95 亿元，同比增长 117.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 3995.88 万元，同比增长 341.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 3915.39 万元，同比增长 2922.77%。

（资料来源：长川科技官网）

半导体材料

【民德电子】预计晶睿电子产能于 12 月达到 10 万片/月的满产

10 月 25 日，民德电子在互动平台上表示，公司参股子公司晶睿电子主营业务为半导体硅片材料的研究、生产和销售，自今年 7 月开始投产，得益于半导体硅片供应持续紧张和市场对晶睿电子团队技术实力的充分认可，晶睿电子已迅速通过近三十家客户批量验证。晶睿电子 8 月产销 1 万多片，9 月产销 4 万多片。该公司表示，预计 12 月份硅外延片产能可达到 10 万片/月的满产，2022 年底扩产至 25 万片/月。晶睿电子为公司参股投资企业，其后续融资及上市等资本规划由晶睿电子团队主导负责，公司将提供相关资源予以支持。关于限电方面，民德电子指出，公司及子公司目前暂未收到限电停产通知，目前公司生产经营一切正常。

（资料来源：投资者互动平台）

晶圆代工

【行业】预估 2022 年晶圆代工产值年增 13% 续创新高，芯片荒现纾缓迹象

根据 TrendForce 集邦咨询表示，在全球电子产品供应链出现芯片荒的同时，晶圆代工产能供不应求的各项涨价效应，推升前十大晶圆代工业者产值在 2020 及 2021 年连续两年皆出现超越 20% 的年增长率，突破千亿美元大关。展望 2022 年，在台积电为首的涨价潮带动下，预期明年晶圆代工产值将达 1,176.9 亿美元，年增 13.3%。

（资料来源：集邦咨询）

【台积电】拉大领先差距！台积电推N4P制程，2022年下半年完成产品设计定案

晶圆代工龙头台积电26日宣布推出N4P制程技术，成为5纳米技术平台之中的效能强化版本，并且加入业界最先进且最广泛的先进制程技术家族。藉由N5、N4、N3以及最新的N4P制程，台积电提供多样且强大的技术组合选择，协助客户实现产品的功耗、效能、面积以及成本优势。台积电指出，做为旗下5纳米家族的第三个主要强化版本，N4P的效能较原先的N5增快11%，也较N4增快6%。相较于N5、N4P的功耗效率提升22%，晶体管密度增加6%。同时，N4P藉由减少光罩层数来降低制程复杂度且改善芯片的生产周期。N4P展现了台积电持续追求及投资提升制程技术的成果。

(资料来源：科技新报)

【世创电子】世创电子在新加坡的新晶圆厂破土动工

10月26日，德国硅晶圆制造商世创电子(Siltronic)宣布，其位于新加坡JTC淡滨尼晶圆厂园区的300mm(12英寸)制造工厂破土动工，预计到2024年底投资约20亿欧元(约合人民币148.06亿元)。据悉，新的300毫米硅晶圆厂将成为世创电子规模最大、最先进的工厂，主要生产单晶以及抛光和外延晶圆，预计将提供600个工作岗位。世创电子表示，大部分投资将在2022年进行，因此处于项目的早期阶段。

(资料来源：联合早报)

封测

【台积电】台积电与Ansys合作，提供3D-IC设计热分析解决方案

先进封装成为半导体制造显学，晶圆代工龙头台积电与EDA厂商和Ansys合作，采用3D Fabric建构的多芯片设计打造全面热分析解决方案，3D Fabric为台积电3D硅堆栈和先进封装技术的全方位系列，以Ansys工具为基础，应用于模拟包含多芯片的3D和2.5D电子系统温度，采用先进台积电3D Fabric技术紧密堆栈。缜密的热分析可防止这些系统因过热故障，并提高使用寿命的可靠性。台积电设计建构管理处副总裁Suk Lee表示，台积电与OIP生态系统伙伴密切合作，运用台积电先进制程和3D Fabric技术在功率、效能和面积带来显著效益，实现下一代设计。本次与Ansys合作，能为完整芯片和封装分析的热解决方案流程提供热解决方案流程，对台积电客户来说深具价值。

(资料来源：科技新报)

第三代半导体

【功率器件】碳化硅市场火热：正海集团与罗姆合资公司成立，专攻碳化硅功率器件

正海集团与罗姆半导体在上海闵行区召开合资公司发布会，宣布双方已经签署合资协议，将共同成立一家主营功率模块业务的新公司，公司全称为“上海海姆希科半导体有限公司(HAIMOSIC(SHANGHAI)CO.,LTD.)”。海姆希科预计将于今年12月注册成立，公司及工厂将坐落于上海市闵行区。新公司将专注于碳化硅功率模块的设计和制造，聚焦新能源汽车市场。海姆希科的碳化硅功率模块将于2022年开始在日本罗姆工厂进行小批量生产。预计2023年开始在闵行区工厂内进行大批量生产。其第一代产品主要面向电动车逆变器领域，根据客户车型及应用场景不同，逆变器效率将提升3%至6%左右。

(资料来源：全球半导体观察)

【功率器件】小米投资上海瞻芯电子，后者聚焦于碳化硅（SiC）半导体领域

据企查查信息，10月22日，上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯电子”）发生工商变更，新增股东先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）等。同时，上海瞻芯电子的注册资本由3571.43万元增加至4375.00万元。据官网介绍，上海瞻芯电子成立于2017年，是一家聚焦于碳化硅（SiC）半导体领域的高科技芯片公司。公司提供以SiC功率器件、SiC驱动芯片、SiC模块为核心的功率转换解决方案，适用于风能逆变、光伏逆变、工业电源、新能源汽车、电机驱动、充电桩等领域。

（资料来源：全球半导体观察）

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓：新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

半导体材料国内市场增速放缓：半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去5年中CAGR达到了10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备：由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20% 以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在 -10%-10% 之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10% 以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自转载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371